



行业动态  
Industry News



### TSMC在中国向客户介绍车用电子工艺验证规格及套装服务

2009-12-04 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

TSMC今(27)日宣布,将于十二月二日在中国厦门所举行的中国半导体行业协会集成电路设计分会年会上,向中国客户介绍汽车业界第一个车用电子工艺验证规格(automotive process qualification specification)及符合车用电子等级的半导体制造套装服务(service package)。同时,TSMC在上海的晶圆十厂也将开始生产车用电子等级的集成电路产品。

TSMC的“车用电子工艺验证规格”符合美国汽车电子协会(Automotive Electronic Council, AEC)所定义的技术标准,系于2008年六月在美国AEC的年度可靠性研讨会中首次提出。由于车用电子元件的耗损常因严峻的操作环境而加速,因此半导体工艺必须确保这些电子元件的寿命大幅超越车辆的使用期限。

TSMC开发的完整“车用电子套装服务”,搭配客户的测试覆盖率(test coverage)及测试方法,能够减少实际行车的故障率(field failure rate)。此一车用电子套装服务包含更严密的工艺管制(tightened process control)、元件层级的筛选界限(device level screen limit)、芯片良率测试报废准则(wafer sorting scrap criteria)、更多的统计工艺控管(SPC monitoring)以及特选的制造机台(preferred tools)等。这些措施经过验证确实能有效降低工艺变异(process variation)及变异值(outliers)。

TSMC全球业务暨行销副总经理陈俊圣指出,全球汽车工业对各种形式IC的需求日益扬升,TSMC将全力支持全球及中国车用电子技术不断创新。我们在上海晶圆十厂投注各种努力,支持中国汽车工业现在及未来的成长,这是我们对这项承诺所采取的确切行动。

TSMC位于台湾的多个晶圆厂以及位于上海的晶圆十厂成功建置车用电子套装服务,全球的汽车供应链包括中国的厂商皆能使用晶圆十厂的车用电子工艺生产线。

(来源: 半导体国际 2009年11月27日)

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号